海外算力扩张下的液冷行业空间 20260907

全球液冷市场 2027 年规模翻倍，2026 年 9 月迎来产业放量拐点

摘要

- 微软、谷歌、Meta、亚马逊资本开支增速超 60%，谷歌接近翻倍，驱动全球液冷市场 2026 年达 1,000 亿元，2027 年翻倍至 2000 亿元，2028 年达 3,000 亿元。
- 英伟达通用芯片 2026 年出货约 800 万片，2027 年含 LPO 芯片达 1,400-1,500 万片；AI 专用芯片（TPU 等）2027 年出货量预计翻倍至 1,600 万片。
- 国内华为升腾 950 系列芯片放量确定性强，预计 2026/2027/2028 年出货量分别为 200 万、350 万、600 万片。
- GB200 机柜液冷零部件价值量拆解：冷板约 6 万元，快接头约 2 万元，管路约 2 万元，零部件价值量随芯片架构升级持续提升。
- 2026 年 9 月为行业关键拐点：谷歌 V7 与英伟达 Rubin 量产爬坡完成，数据中心液冷基建改造磨合期结束，核心公司三季度业绩兑现可见度显著提升。
- 2026 年 10 月 OCP 峰会为重要催化剂，英伟达 Rubin 下一代液冷架构及谷歌第六/七代方案前瞻指引将明确中长期技术路径。

Q&A

全球主要云服务厂商的资本开支趋势如何？这对液冷市场的驱动作用体现在哪些方面？

全球九大云服务厂商，包括谷歌、亚马逊、Meta、微软、腾讯、阿里和百度，其合计资本开支在 2026 年已接近 9,000 亿美元，同比增长近一倍。预计 2027 年将在此基础上保持约 50%的增速，达到 1.3 万亿美元。其中，微软、谷歌、Meta 和亚马逊等厂商的增速普遍在 60%以上，谷歌的资本开支增长尤为激进，接近翻倍。这种强劲的资本开支增长，为液冷市场提供了强大的驱动力。



从芯片出货量的角度看，未来几年 AI 芯片市场的增长预期是怎样的？

从芯片出货量来看，市场将持续保持高增长。具体来看：

1. 通用芯片领域，以英伟达为代表，预计 2026 年芯片出货量约为 800 万片；2027 年，加上 LPO 芯片后，总出货量预计达到 1,400 万至 1,500 万片；到 2028 年，预计将达到 2000 万片。
2. AI 专用芯片领域，包括谷歌的 TPU、亚马逊、Meta 及 AMD 的产品，在剔除不使用液冷的旧版本芯片（如谷歌 V4、V5）后，2026 年的出货量接近 800 万片；预计 2027 年将实现翻倍增长，到 2028 年达到约 2000 万片。
3. 国内市场方面，华为升腾 950 系列芯片预计 2026 年出货量略超 200 万片，2027 年将增至 350 万片，2028 年预计达到 600 万片。

基于芯片出货量的预测，液冷市场的整体规模以及未来几年的增长前景如何？

基于明确的单机柜芯片架构和芯片出货预期，可以推算出液冷机柜的数量。通过对不同芯片方案（如 GB200、TB300、Rubin、谷歌 TPU、Meta 及亚马逊芯片）的液冷机柜内各零部件（如冷板、快接头、管路、CDU、阀件、过滤器和控制元件）的价值量进行分拆测算，例如 GB200 机柜中冷板价值量约 6 万人民币，快接头价值量为 2 万人民币，管路价值量约为 2 万人民币。汇总测算后，预计全球液冷市场空间在 2026 年将达到约 1,000 亿元人民币，2027 年在此基础上翻倍至 2000 亿元，到 2028 年将进一步增长至 3,000 亿元。

为什么说 2026 年 9 月是液冷行业发展的关键拐点？有哪些具体的催化因素？

2026 年 9 月被视为液冷行业的关键拐点，主要基于以下几个因素的叠加影响：首先，核心芯片的量产和爬坡进入关键期。谷歌 V7 芯片自 7 月开始量产后，经历了两个月的良率爬坡期，同时数据中心在从风冷转向液冷架构时，也需要基建改造和与供应商的磨合期。这些影响放量的因素预计在 9 月份基本解决。此外，英伟达 Rubin 平台自 8 月量产后，也将在 9 月至 10 月进入关键上量阶段。 其次，行业内核心公司的三季度经营状况可见度将在 9 月中下旬显著提升。届时，市场将能更清晰地观察到哪些公司开始兑现液冷业务的收入和利润，以及其盈利能力水平。 最后，10 月份即将召开的全球 OCP 峰会预计将带来新的催化剂。届时，英伟达可能会发布关于 Rubin 及下一代液冷架构或产品的信息，谷歌也可能对其第六代、第七代方案提供前瞻性指引。这些密集的催化事件共同构成了 9 月份布局液冷贝塔行情的重要时间窗口。